

华为与24家公司签署开源鸿蒙生态使能合作协议 多家A股上市公司参与其中

■本报记者 李昱丞
见习记者 李雯珊

1月10日,《证券日报》记者从华为官方获悉,在开放原子开源基金会的指导下,华为与24家伙伴签署OpenHarmony(开源鸿蒙)生态使能合作协议,覆盖金融、教育、交通、能源、政务、制造等行业,共同推动OpenHarmony生态的繁荣与发展。

“2022年在各家共建伙伴的共同努力下,OpenHarmony系统能力持续增强,生态进展在各行各业领域加速推进,已有102款商用设备、94款开发板模组和28款软件发行版通过了社区兼容性测评。”华为终端BG软件部总裁龚体对外表示。

据《证券日报》记者梳理,此次参与签约的24家公司中有不少是

A股上市公司。

曾表示持续软件开源开放

据悉,OpenHarmony是由开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)孵化及运营的开源项目,目标是面向全场景、全连接、全智能时代,基于开源的方式,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。

此前,华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛对外表示,“数字中国的发展需要强大的数字基础设施,华为将在三方面持续努力——聚焦根技术投入构筑产业根基,持续软件开源开放并与全产业共建,赋能产业生态共筑产业未来。”

公开资料显示,华为开源操

作系统欧拉加速发展,社区企业成员从2021年的300家,发展到2022年超过600家;部署数量从100万套,到2022年累计300万套,新增市场份额占比约25%。欧拉正在跨越生态,成为各行业数字化转型的首选。

“开源是开放创新的有效手段,是数字时代的事实标准和专利。现今开源代码的使用已经遍布每个角落并在逐年提升,这意味着千行百业的应用创新站在开源的肩膀之上。”招商证券一位不具名的分析师向《证券日报》记者表示。

该分析师认为,华为为开源业务发展的雄心在于,将其目光聚焦在基础软件根技术,意图以开源软件为支点,打造稳固数字世界底座的基础,共同推动中国成为全球开源软件价值体系中的关键

力量。

繁荣开源鸿蒙生态

“OpenHarmony作为产业界共同建设、维护的重要开源项目,凝聚了各成员单位、共建伙伴、生态参与方积极创新的成果,也承载了大家对下一代操作系统发展以及未来产业变革的期待。”开放原子开源基金会秘书长冯冠霖在签约活动现场表示。

他希望,新加入OpenHarmony生态的伙伴能够充分发挥各自行业和领域的优势,广泛吸纳千行百业的相关需求,共谋行业发展;通过开源共建,让更多行业用户和消费者能感受到OpenHarmony所带来的万物互联价值,吸引更多的伙伴加入。在服务好行业客户的同时,积极回馈开源社区,为更多的

伙伴提供行业经验参考,携手繁荣OpenHarmony生态。

同时,根据华为官方披露的信息,此次参与签约的24家公司中有不少是上市公司,其中以广东地区的上市公司占比较多,主要覆盖家电、通讯网络、金融、支付、芯片等领域,例如深康佳A、创维集团、广和通、金溢科技、锐明技术、新国都、冠石电子、芯海科技、九联科技等。

“为了支持更多行业的发展,繁荣OpenHarmony生态,华为需要更多产业链的伙伴加入,当前阶段来看,主要包括芯片厂商、模组开发板厂商、设备厂商等,这些类型的公司有利于与华为一同,合作共建千行百业的数字底座,开创万物互联产业新格局。”翼虎投资研究员周佳向《证券日报》记者表示。

传艺科技:已向两轮车和储能客户送出钠电池样品 业界积极推动小动力场景规模化应用

■本报记者 李春莲
见习记者 彭衍菴

传艺科技1月9日披露的“投资者关系活动记录表”记载,在当日接受机构调研时,传艺科技方面表示,2023年钠电池实际出货预期达到2GWh至3GWh。此外,公司方面还介绍,“从上周开始,陆续给客户进行送样,客户主要类型是两轮车和储能领域,送样的钠电池价格一般比磷酸铁锂便宜25%至30%。”

去年12月份以来,宁德时代、比亚迪、中科海钠、维科技术、鹏辉能源、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、多氟多、普利特和众钠科技等多家企业宣布了钠离子电池量产的最新进展。此外,目前不少上市公司正积极推进钠电池小动力场景的规模化应用,业内对2023年钠电池量产持乐观态度。

川财证券首席经济学家陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,2023年钠电池将开启规模化应用,也将有更多锂电企业着手布局钠电池,推动其产业化进一步加速。

钠电池成本将持续降低

近期,随着锂电终端需求低迷,钠电池所使用的负极、隔膜、电解液、锰源、铁源等材料价格也均有一定幅度下调。

上海钢联新能源事业部钠电池分析师汪奇向《证券日报》记者介绍,钠电池规模化生产后的平均成本比磷酸铁锂电池便宜25%至35%,磷酸铁锂电池平均成本在0.6元/Wh至0.7元/Wh。

汪奇认为,传艺科技钠电

池中试线成本应在0.55元/Wh左右,全部达产后能达到0.45元/Wh以下,达到相对磷酸铁锂电池成本约25%的降幅;而其他钠电池企业生产规模达到5GWh至10GWh,成本水平才能符合市场预期。

对于钠电池未来的价格走势,汪奇认为,本轮价格下调预计将持续到2月底,随着下游逐步复工复产且临近旺季,在需求的拉动下,3月份后钠电池价格有望走强。不过,后续价格走势还需根据钠电池在小动力场景的规模化应用情况再做判断。

汪奇表示,“钠电池价格走势取决于其市场化程度。定价合理与否也取决于应用场景,比如相对于动力电池,钠电池目前定价较为合理;但对于储能,定价则偏高。”

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤向记者表示,钠电池成本还需进一步降低。“比如在能量密度、稳定性、循环寿命上还需要逐步提升。”

小动力应用率先落地

传艺科技“投资者关系活动记录表”还记载,“目前传艺科技中试生产的产品已经达到超过5000次的循环寿命,可以满足A00级车、小动力车、两轮车和储能的客户使用需求。如果未来客户需要更高的循环寿命,那么公司将在二期的建设过程中,增加聚阴离子类电池产品的投入”。

“小动力场景主要包括两轮电动车、小型电动工具等低性能、低容量的产品。成熟的应用案例,比如爱玛电动车就由维科技术和浙江纳创提供钠电池技术支持。”在



汪奇看来,今年下半年钠电池可以实现规模化应用,2025年前后产量有望达到50GWh以上。

去年以来,已有多家锂电企业宣布钠电池量产计划。维科技术1月9日在投资者互动平台表示,“公司目前对于钠电池的规划产能是2GWh,投资金额预计为

6.8亿元,主要面向低速车和储能。”据了解,该2GWh项目将于2023年6月底量产。

汪奇认为,2023年全国钠电池产量可能在15GWh左右,3年至5年规划产能则有超过150GWh。“对于中下游企业,与低速动力、储能领域的头部企业进

行合作存在机遇,这有利于产能尽早达产,争取更大的市场份额,也有利于进一步挖掘钠电池降本潜力。”汪奇说。

祁海坤表示,“随着钠电池在储能领域、低速电动车等领域不断渗透,可以促使钠电池成本进一步降低。”

辉瑞称今年上半年 将在中国提供Paxlovid 华海药业股价昨日应声上涨

■本报记者 吴文婧

连日来,受辉瑞新冠口服药Paxlovid(奈玛特韦片/利托那韦片组合包装)在国内销售的相关消息影响,其委托生产合作方华海药业备受市场关注。

尽管Paxlovid无缘2022年国家医保目录,但辉瑞首席执行官艾伯乐(Albert Bourla)1月9日在JP摩根医疗健康大会上表示,“正与中国的合作伙伴携手,预计从2023年上半年开始在中国提供Paxlovid。”

1月10日,华海药业盘中大涨,截至收盘涨幅达7.73%。华海药业方面表示,“公司积极配合辉瑞加速推进Paxlovid本土化项目的各项工作,以保障Paxlovid在中国市场的充足供应。”

据了解,2022年8月份,辉瑞与华海药业就Paxlovid签署本地化生产协议,华海药业将在协议期内(5年)为辉瑞在中国大陆市场销售的新冠病毒治疗药物Paxlovid提供制剂委托生产服务。根据协议约定,辉瑞将提供奈玛特韦原料药与利托那韦制剂,华海药业负责奈玛特韦制剂生产,并完成组合包装。

有不愿具名的医药业内人士向《证券日报》记者表示,“自2015年试点以来,MAH(药品上市许可持有人)制度逐渐在全国范围内推行,其将药品上市许可与药品生产许可‘分离’,而Paxlovid本地化生产取决于生产许可证的获得。”

事实上,承接跨国药企的生产订单,对本土药企的工艺研发水平、生产与质量管理水平等都有非常严格的要求,与辉瑞的合作也显示出华海药业在CMO/CDMO领域的实力。辉瑞方面曾表示,依托双方资源优势,Paxlovid由华海药业进行本地化生产将有助于提升患者的药物可及性。

除此之外,华海药业获MPP(日内瓦药品专利池组织)授权仿制辉瑞新冠口服药,可向印度尼西亚、越南、埃塞俄比亚等95个中低收入国家或地区提供相关产品的商业化许可。

华海药业在日前的投资者业绩交流会上表示,公司获MPP授权使用相关专利和专有技术生产口服新冠病毒治疗药物“奈玛特韦”的仿制药和许可产品“奈玛特韦/利托那韦组合”项目目前进展顺利,原料药及制剂产品均已提交WHO审评;同时,相关原料药产品已供多个客户用于其制剂产品的注册申报。

辉瑞财报显示,2022年二季度,Paxlovid在全球实现81亿美元销售;2022年三季度,Paxlovid全球销售收入为75.14亿美元。华创证券认为,预计新冠口服药物在欧美发达国家市场规模在300亿美元级别。

金刚光伏宣布吴江产线 全面使用130μm硅片 行业以薄片化推动降本

■本报记者 王丽新 见习记者 陈瀚

硅片薄片化进程正在加快,1月10日,金刚光伏宣布,吴江产线已全面使用130μm厚度硅片进行量产。未来公司将继续导入110μm、100μm厚度硅片,加速推进高效微晶异质结电池(HJT)的薄片化。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤就此向《证券日报》记者表示,硅片薄片化和大尺寸化是行业趋势,可以有效降低非硅成本,但这一进程可能影响企业生产良率,还可能影响硅片与下游电池、组件环节的匹配。“不过,目前来看,130μm产品的良率不错。”

薄片化是光伏降本手段之一

公开资料显示,金刚光伏成立于1994年,原名为金刚玻璃,此前主要专注各类高科技特种玻璃及系统研发、设计、生产,产品包括防火幕墙、建筑玻璃等。

2021年6月份,金刚玻璃官宣进军光伏产业,以全资子公司吴江金刚玻璃科技有限公司为实施主体,投资建设1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目;2022年10月10日,金刚玻璃全称由“甘肃金刚玻璃科技股份有限公司”变更为“甘肃金刚光伏股份有限公司”,公司证券简称由“金刚玻璃”变更为“金刚光伏”。

据金刚光伏公告,目前公司吴江1.2GW项目有两条单面微晶异质结电池产线,此外酒泉4.8GW项目已启动一期项目建设,首批双面微晶异质结电池片产线已进场安装。

作为下一代高效电池技术的主流选择之一,异质结电池成本较高,硅片薄片化是降本手段之一,但考虑到良率,依然有较少企业在2022年采用150μm以下厚度硅片。

西南证券电池新能源团队曾表示,硅片薄片化为HJT电池降本的重要途径之一,在硅料产能持续投放的背景下,硅片厚度每下降10μm,HJT硅片成本有望下降约4%。硅片减薄将直接推动HJT原材料成本大幅下降,因此硅片薄片化动力依然充足。

多家企业积极推进薄片化

除金刚光伏外,设备厂商高测股份近日也发布公告,宣布持续推进异质结电池薄片化。

1月4日,高测股份公告称与东方日升构建战略合作伙伴关系,共同推进在N型异质结超薄半片切片领域——截、开、磨、切装备及金刚线等方面的合作。合作期内,高测股份将方棒加工成合格的100μm厚度及更薄厚度的N型异质结半片超薄硅片向东方日升销售。此外,高测股份于2022年8月份在行业实现了首发80μm超薄硅片。

据了解,另一硅片巨头TCL中环HJT硅片量产片在2022年也已经由150μm切换至130μm,同时还在进行120μm及以下超薄硅片的开发。

浙商证券预计,随着硅片厚度从150μm降至120μm,以及其他成本降低,2023年HJT电池成本有望与PERC持平。

“我认为今年130μm有望成为主流,但120μm会有一定难度。”祁海坤谨慎表示,但即便硅片薄片化进展顺利,异质结电池、组件成为主流产品或许需要两到三年时间。“因为降本必须打通包括硅片、电池片、组件所有制造环节;而硅片薄片化也需要工艺人员及相关设备厂家协作努力。”

技术突破、国产化加速 A股芯片板块有望迎来估值修复

■本报记者 向炎涛

1月10日,A股芯片板块全线走高,其中汽车芯片、半导体及元件、第三代半导体等概念涨幅居前。

“长期来看,半导体行业国产化需求明显,供应链国产化水平有待提升,国产厂商成长机会突出。同时,A股半导体板块已经历了比较充分的调整,估值处在历史底部,具备较好投资价值。”一位券商分析人士对《证券日报》记者表示。

国产小芯片4nm封装量产

全球半导体产业激烈竞争下,国产厂商不断实现技术突破,半导体产业链国产化程度不断提升。

近日,长电科技宣布,公司XDFOI™ Chiplet高密度多芯异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段,同步实现国际客户4nm

节点多芯系统集成封装产品出货,最大封装体面积约为1500mm²的系统级封装。

长电科技表示,随着近年来高性能计算、人工智能、5G、汽车、云端等应用的蓬勃发展,要求芯片成品制造工艺持续革新以弥补摩尔定律的放缓,先进封装技术变得越来越重要。应市场发展之需,长电科技于2021年7月份正式推出面向Chiplet(小芯片)的高密度多芯异构集成技术平台XDFOI™,利用协同设计理念实现了芯片成品集成与测试一体化,涵盖2D、2.5D、3D Chiplet集成技术。

在先进封装技术方面,国内厂商正在发力。《证券日报》记者从通富微电了解到,该公司启动了“立足7nm,进阶5nm”战略,深入开展5nm新品研发,全力支持客户5nm产品导入,现已完成研发逐步量产。

CINNO Research半导体事业

部总经理徐耀芳对《证券日报》记者表示,长电科技在4nm封装领域的突破具有积极意义——中国在先进封装已经跨入国际先进水平。一方面可以利用先进的多芯异构芯片封装技术提升现有成熟工艺芯片的整体性能,另一方面则是借助先进的封装技术更深入了解先进制造工艺的难点,从而助力加快先进工艺的研发。

随着先进封装技术的不断发展,国内芯片公司纷纷布局Chiplet领域。Chiplet即所谓小芯片,是把一颗大的芯片分成几个更小的晶片,然后再通过先进封装整合为一颗功能完整的芯片,如中央处理器、类比元件、存储器等产品。在不少业内人士看来,集成电路进入后摩尔时代,制程技术突破难度较大,工艺制程受成本大幅增长和技术壁垒等因素改进速度放缓,先进封装成为提升芯片性能的重要途径。

“Chiplet面临的最大挑战是连接问题。大多数企业还没有足够的专业知识,包括设计能力、D2D互连和制造策略等,这为小芯片进一步发展带来困难。如何提高国内IC设计公司在软件及硬件上的设计能力实为当务之急。”徐耀芳说。

供应链国产化提速

在国产半导体厂商发力的同时,越来越多国内企业在供应链环节采用国产芯片。

2022年12月4日,中国建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标结果,其中就包括飞腾、鲲鹏、海光等国产服务器。

中国电信此前公布的2022年至2023年服务器集中采购项目中标结果显示,中标的12家厂商全部是国内企业,包括中兴通讯、紫光华山(新华三子公

司)、浪潮信息、超聚变、烽火通信、湘江鲲鹏等。

探索科技首席分析师王树一对《证券日报》记者表示:“只要本土厂商能够做出质量过硬的产品,就会得到进入供应链的机会。因为本土终端厂商更关注供应链的安全性。”

王树一认为,目前本土先进封装和先进制程与国际一流水准还存在差距,其中制造的差距更大,封装差距小一些。但先进封装与先进制程的关联日益紧密,所以如果本土制造不能取得突破,则先进封装技术的发展也会面临挑战。

中邮证券认为,半导体下行周期进入尾声,芯片需求复苏可期。芯片板块估值处于历史底部位置,伴随智能化、数字化的大趋势继续演绎,芯片需求有望复苏。芯片设计等相关标的有望迎来业绩和估值的双重修复。